

JEDNOLITE ZASTOSOWANIE NOMENKLATURY SCALONEJ (CN)**(Klasyfikacja towarów)**

(2006/C 166/07)

Noty wyjaśniające przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ⁽¹⁾

W Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich ⁽²⁾ wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 9 istniejącym pod tekstem wstawia się następujący tekst:

„G. Bezcłowe traktowanie wielochipowych układów scalonych (MCP)

Wielochipowe układy scalone składające się z dwóch lub więcej zespolonych monolitycznych układów scalonych, połączonych niepodzielnie pod każdym względem, nawet na jednym lub więcej podłożu izolacyjnym, z ramkami wyprowadzeniowymi lub bez, lecz bez żadnych innych czynnych lub biernych elementów układu.

Wielochipowe układy scalone na ogół występują w następujących konfiguracjach:

- dwa lub więcej monolityczne układy scalone zamontowane obok siebie;
- dwa lub więcej monolityczne układy scalone umieszczone jeden na drugim;
- kombinacje powyższych konfiguracji składające się z trzech lub więcej monolitycznych układów scalonych.

Te monolityczne układy scalone są połączone i zespolone w jedną całość i mogą być pakowane w obudowę lub w inny sposób. Są one połączone niepodzielnie pod każdym względem, tj., mimo że niektóre z elementów mogłyby być usunięte i zastąpione innymi, to byłoby zadanie długotrwałe i delikatne, nieopłacalne w normalnych warunkach produkcyjnych.

Podłoża izolacyjne wielochipowych układów scalonych mogą zawierać obszary przewodzące. Obszary te mogą być utworzone ze ściśle określonych materiałów lub uformowane w specyficzne kształty, w celu zapewnienia funkcji biernych za pomocą środków innych niż dyskretne elementy układu. Gdy w podłożu są obecne obszary przewodzące, służą one jako środki, za pomocą których monolityczne układy scalone są wzajemnie połączone. Podłoża te mogą być również określane jako »wstawki« lub »przekładki«, gdy umieszczone są ponad najniższym położonym chipem lub płytką półprzewodnikową.

Monolityczne układy scalone są wzajemnie połączone za pomocą różnorodnych środków, takich jak spoiwa, złącza przewodowe lub technologię przerezutnika (tzw. technologia »flip-chip«).

Wielochipowe układy scalone klasyfikuje się następująco:

- i) Wielochipowe układy scalone, które stanowią kompletną maszynę lub kompletne urządzenie (lub maszynę lub urządzenie klasyfikowane jako kompletne) — do pozycji odpowiedniej dla tej maszyny lub tego urządzenia;
- ii) Pozostałe wielochipowe układy scalone — zgodnie z postanowieniami w sprawie klasyfikacji części maszyn (w szczególności, uwaga 2 (b) i 2 (c) do sekcji XVI).

Wyłącznie wielochipowe układy scalone, które klasyfikowane są do pozycji: 8418, 8422, 8450, 8466, 8473, 8517, 8518, 8522, 8523, 8525, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548, 8708, 9009, 9026, 9031 i 9504 kwalifikują się do tej ulgi celnej.”

⁽¹⁾ Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 996/2006, (Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 26).

⁽²⁾ Dz.U. C 50 z 28.2.2006, str. 1.

Na stronie 344:

8542 Układy scalone i mikroasemblery, elektroniczne

Pod tekstem istniejącym wstawić następujący tekst:

„Niniejsza pozycja nie obejmuje wielochipowych układów scalonych (MCP) składających się z dwóch lub więcej zespolonych monolitycznych układów scalonych połączonych niepodzielnie pod każdym względem, nawet na jednym lub jednym lub więcej podłożu izolacyjnym, z ramkami wyprowadzeniowymi lub bez, lecz bez żadnych innych czynnych lub biernych elementów układu [patrz także Noty wyjaśniające do Sekcji II — Przepisy szczególne, G. »Bezcłowe traktowanie wielochipowych układów scalonych (MCP)].«”
